



Nov. 2, 2011

TAIEX : 8070

CWE Commit to Total Excellence

大綱

- 公司簡介
- 2011第三季營運績效
- 公司未來展望
- Q&A

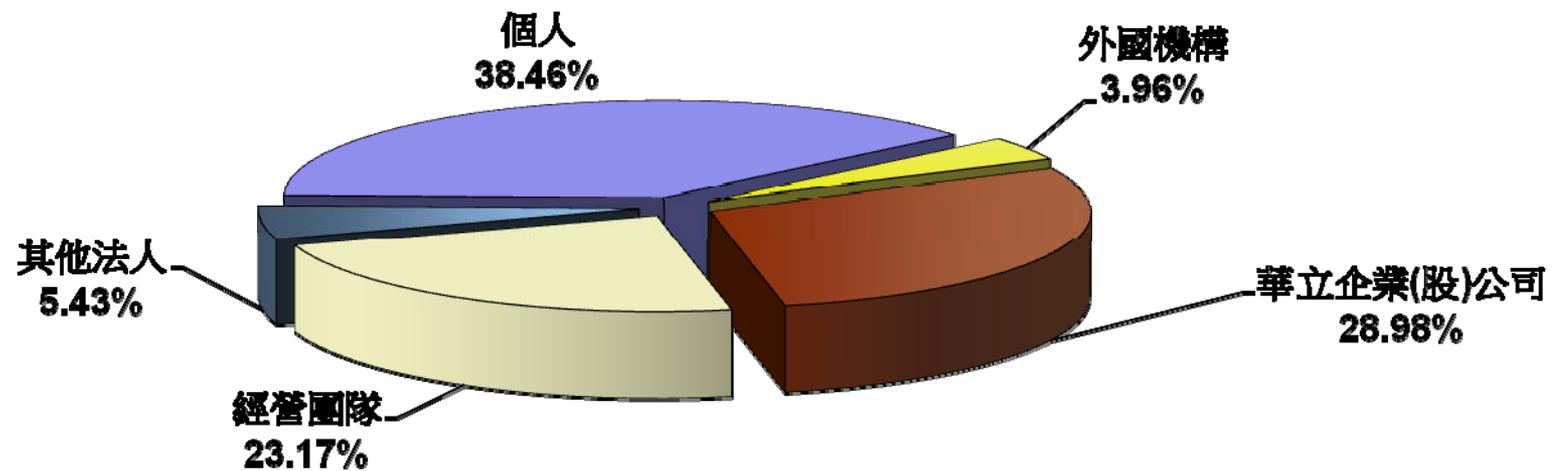
公司簡介

設立日期	1989年5月13日
董事長/執行長	黃嘉能
總經理/營運長	盧簡文
實收資本額	新台幣\$629百萬元 (美金\$21百萬元)
員工人數	170人(單一)；1,990人(合併)
主要產品/產業範圍	IC 封裝材料設備 (半導體產業) Handset週邊產品材料 (3C產品產業) TFT LCD 背光模組材料 (面板產業) 觸控面板材料 (面板產業)
營業據點	高雄 (總公司) 台北 (分公司) 中壢 (營業所) 台中 (營業所) 竹南 (子公司) 上海 (子公司) 吳江 (子公司) 深圳 (子公司)

子公司概況

產業類別	被投資公司名稱	主要產品	持股比率 %
IC封裝材料 設備	台灣住礦電子(股)公司	製造IC導線架及COF軟性基板	30%
	成都住礦電子有限公司	製造導線架電鍍	30%
	成都住礦精密製造有限公司	製造導線架沖壓	30%
LCD背光模 組材料	華德光電材料科技(股)公司	製造銷售光學膜(BEF、MBEF、MICROLENS)	49%
	吳江斌茂光電有限公司	光學膜裁切	100%
	長華科技(股)公司	製造LED導線架	51%
Handset產品 材料	濠瑋(深圳)精密科技有限公司	製造銷售精密金屬零組件(端子、天線、彈片等)	90%
	濠鈺科技(深圳)有限公司	製造汽機車配件及電子電器配件壓鑄	90%
通路商	上海長華新技電材有限公司	銷售IC封裝材料及設備	69%
	云輝科技(股)公司	銷售Touch Panel材料	51%
	CWER Co., Ltd.	國際貿易	100%
	長伯科技(股)公司	太陽能產業材料通路	100%

股東結構(2011.7.22)



2011第三季營運績效

2011年第三季營運績效(單一)與上季比較

單位：NT百萬元

	2011年第三季		2011年第二季		變動率
	金額	%	金額	%	%
營業收入	2,593	100.0	2,961	100.0	(12.4)
銷貨成本	2,381	91.8	2,751	92.9	(13.4)
營業毛利	212	8.2	210	7.1	1.0
營業費用	56	2.2	50	1.7	12.0
營業淨利	156	6.0	160	5.4	(2.5)
營業外損益	(72)	(2.8)	11	0.4	(754.5)
稅前淨利	84	3.2	171	5.8	(50.9)
所得稅	2	0.1	50	1.7	(96.0)
本期淨利	82	3.2	121	4.1	(32.2)
每股盈餘(元)-稅前	1.32		2.66		
每股盈餘(元)-稅後	1.29		1.87		

*每股盈餘以2011年9月30日流通在外股數62,922,534股計算

*3Q合併營收4,231M(2Q 4,082M) QOQ=3.65%

2011年前三季營運績效(單一)

單位：NT百萬元

	2011年前三季		2010年前三季		變動率 %
	金額	%	金額	%	
營業收入	8,387	100.0	9,697	100.0	(13.5)
銷貨成本	7,770	92.6	9,055	93.4	(14.2)
營業毛利	617	7.4	642	6.6	(3.9)
營業費用	157	1.9	200	2.1	(21.5)
營業淨利	460	5.5	442	4.6	4.1
營業外損益	(64)	(0.8)	441	4.5	(114.5)
稅前淨利	396	4.7	883	9.1	(55.2)
所得稅	76	0.9	105	1.1	(27.6)
本期淨利	320	3.8	778	8.0	(58.9)
每股盈餘(元)-稅前	6.28		14.03		
每股盈餘(元)-稅後	5.08		12.36		

*每股盈餘以2011年9月30日流通在外股數62,922,534股計算

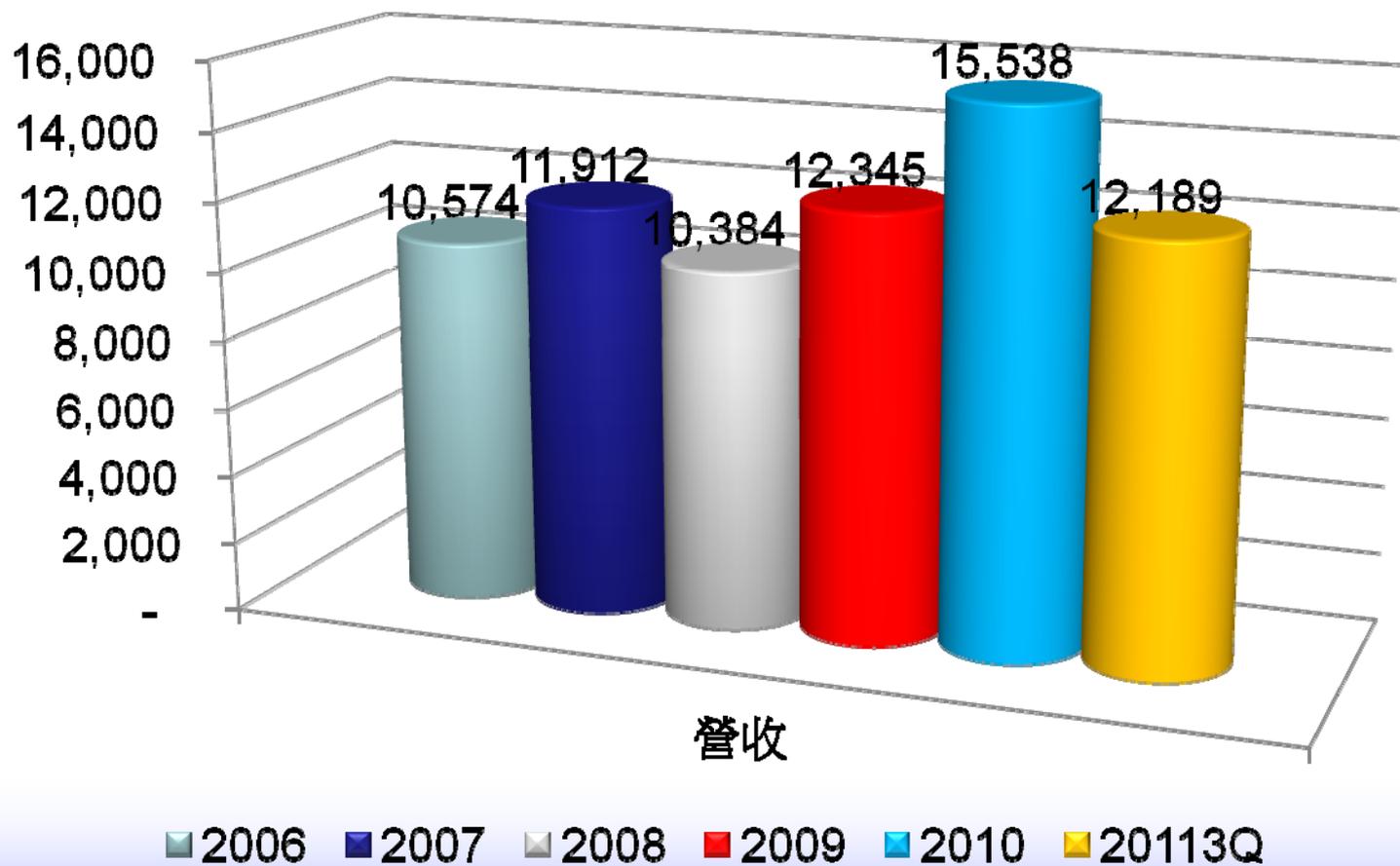
2007~2011年資產負債表摘要(單一)

單位: NT百萬元	2007.12.31	2008.12.31	2009.12.31	2010.12.31	2011.9.30
現金及短期投資	297	728	1,139	715	428
應收帳款	2,666	1,588	2,497	2,163	2,390
流動資產	3,609	2,646	4,034	3,772	4,053
長期投資	993	1,552	2,108	2,492	2,568
流動負債	2,801	1,220	2,296	2,226	3,618
長期負債	-	1,461	1,560	1,677	999
股東權益	2,582	2,285	3,022	3,201	2,850
總資產	5,428	5,032	6,956	7,154	7,584
每股淨值(元)	44.03	37.41	49.47	52.40	45.30
流動比率	129%	217%	176%	169%	112%
負債比率	52%	55%	57%	55%	62%

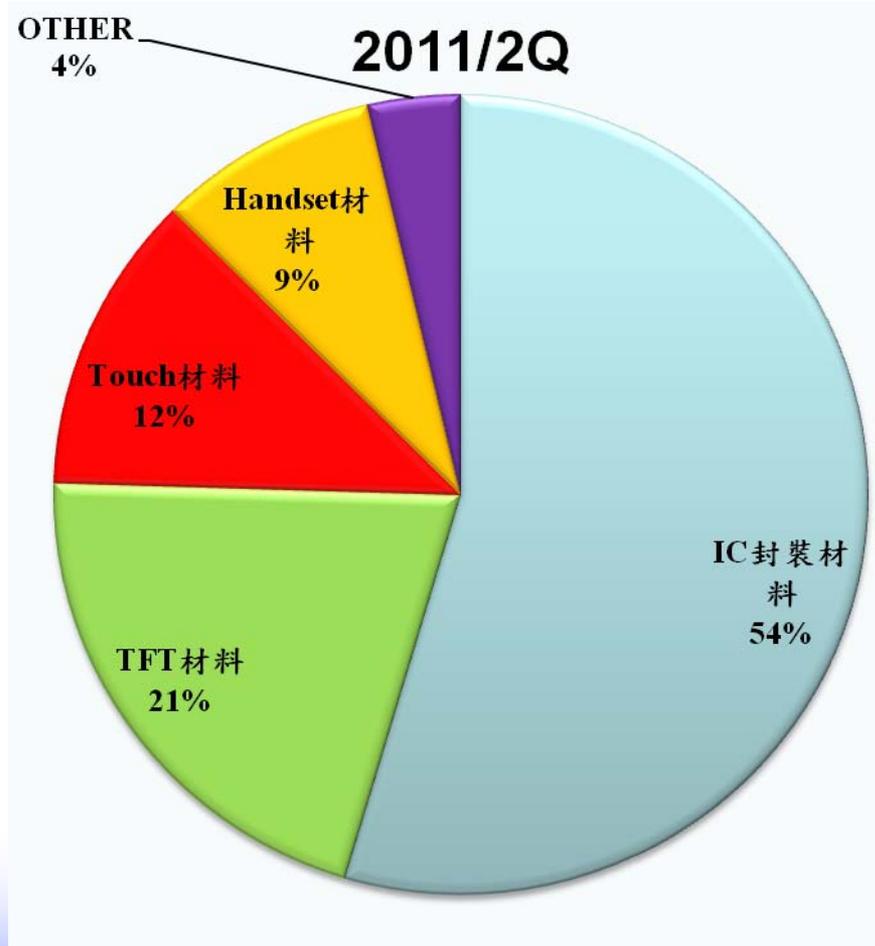
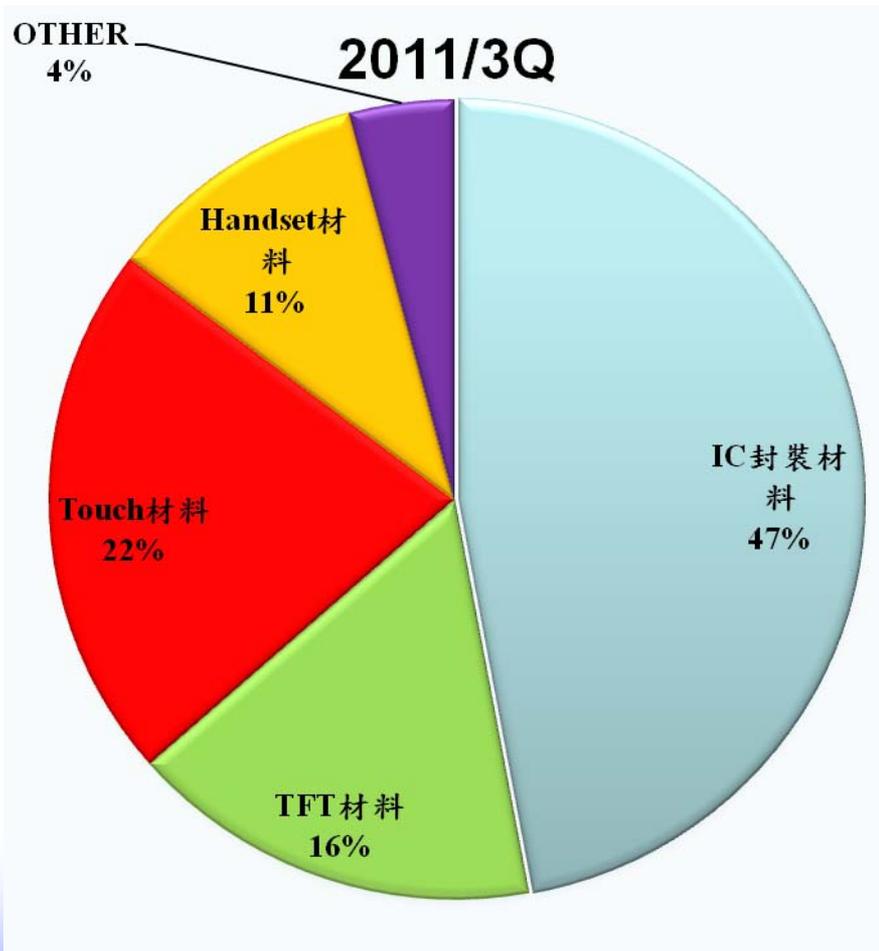
*2011.9.30資產負債表為會計師核閱數。

合併營收

Unit: NT\$MN

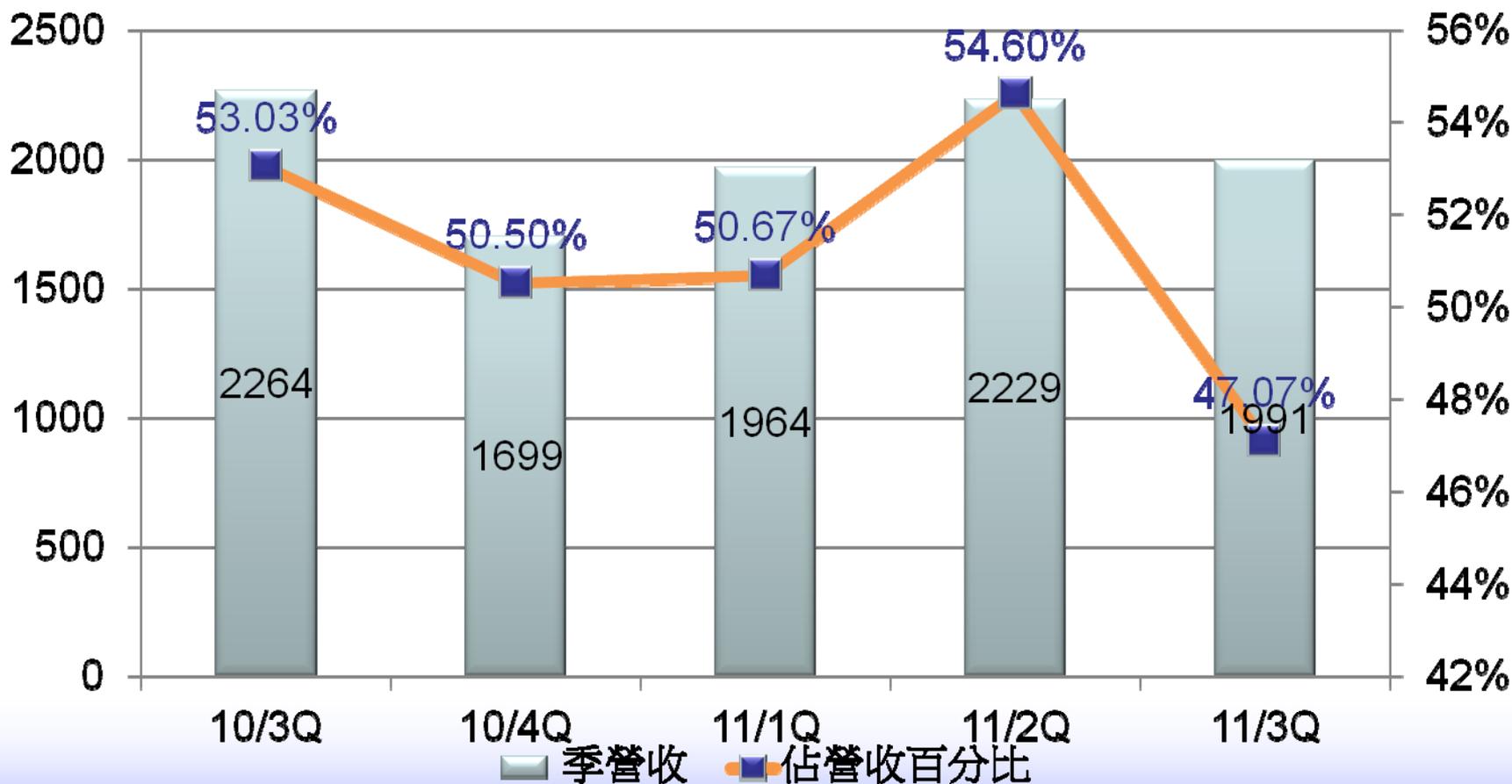


合併營收依產品別區分



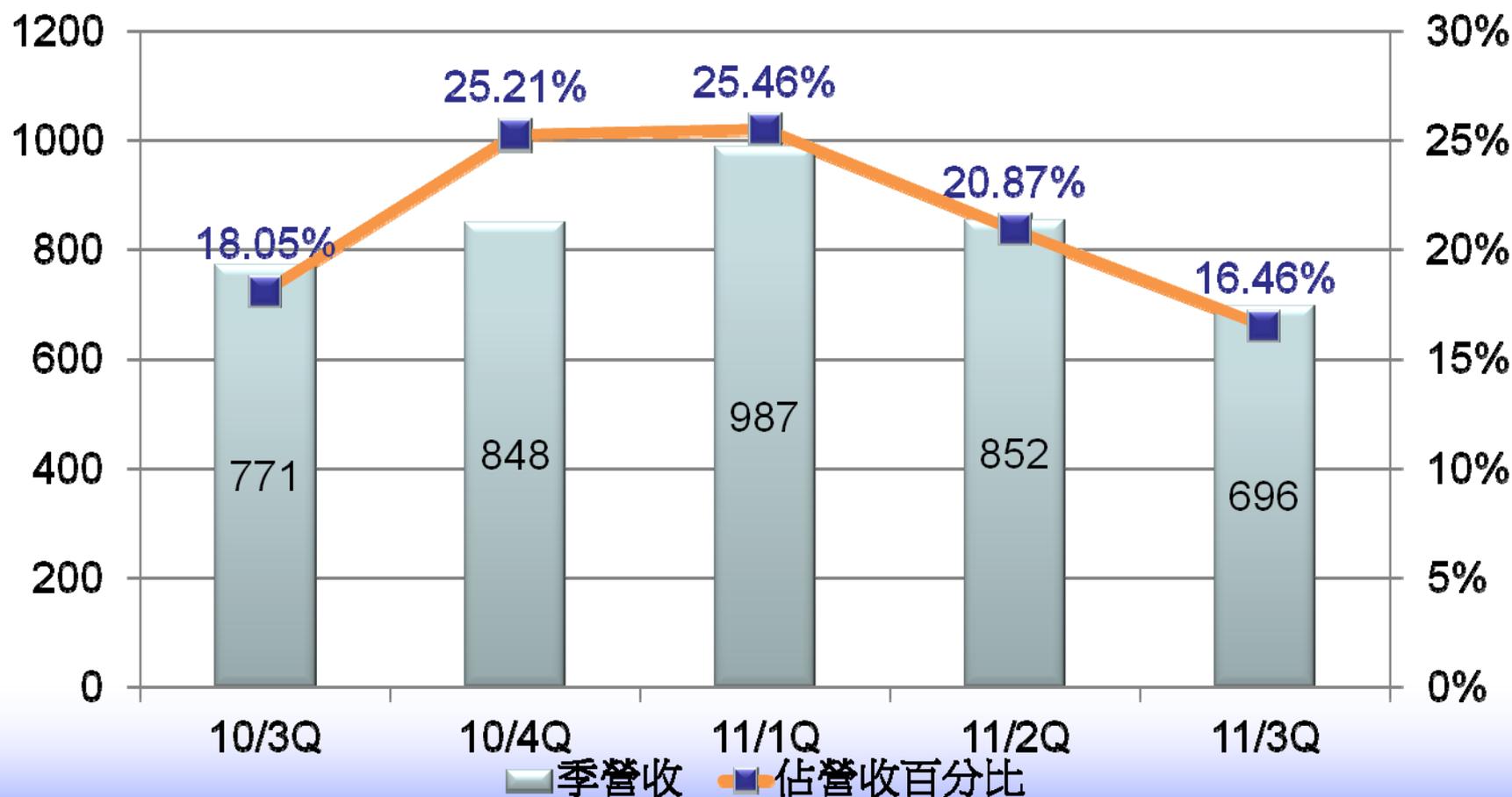
IC封裝材料營收趨勢

Unit: NT\$MN



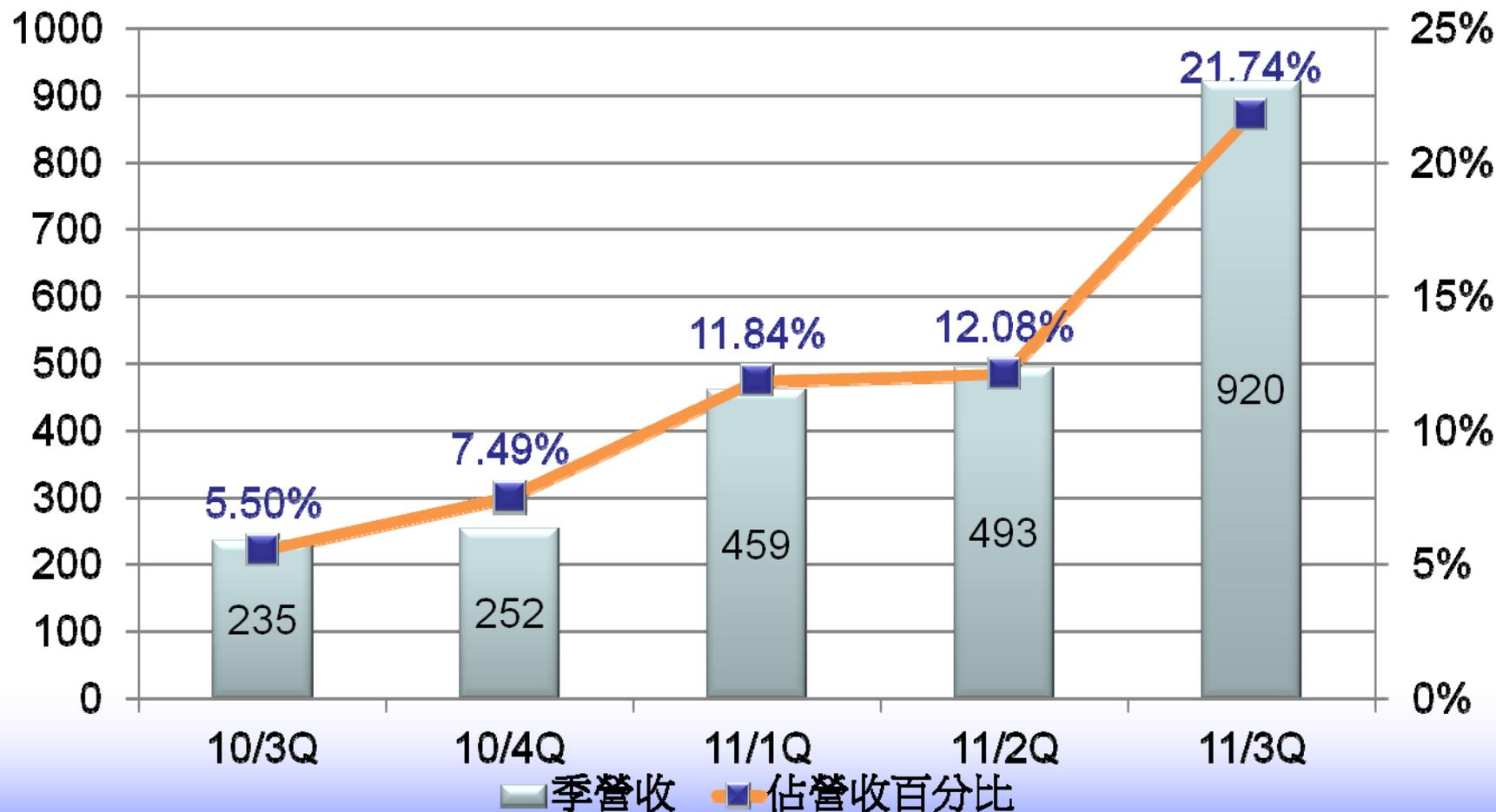
TFT LCD材料營收趨勢

Unit: NT\$MN



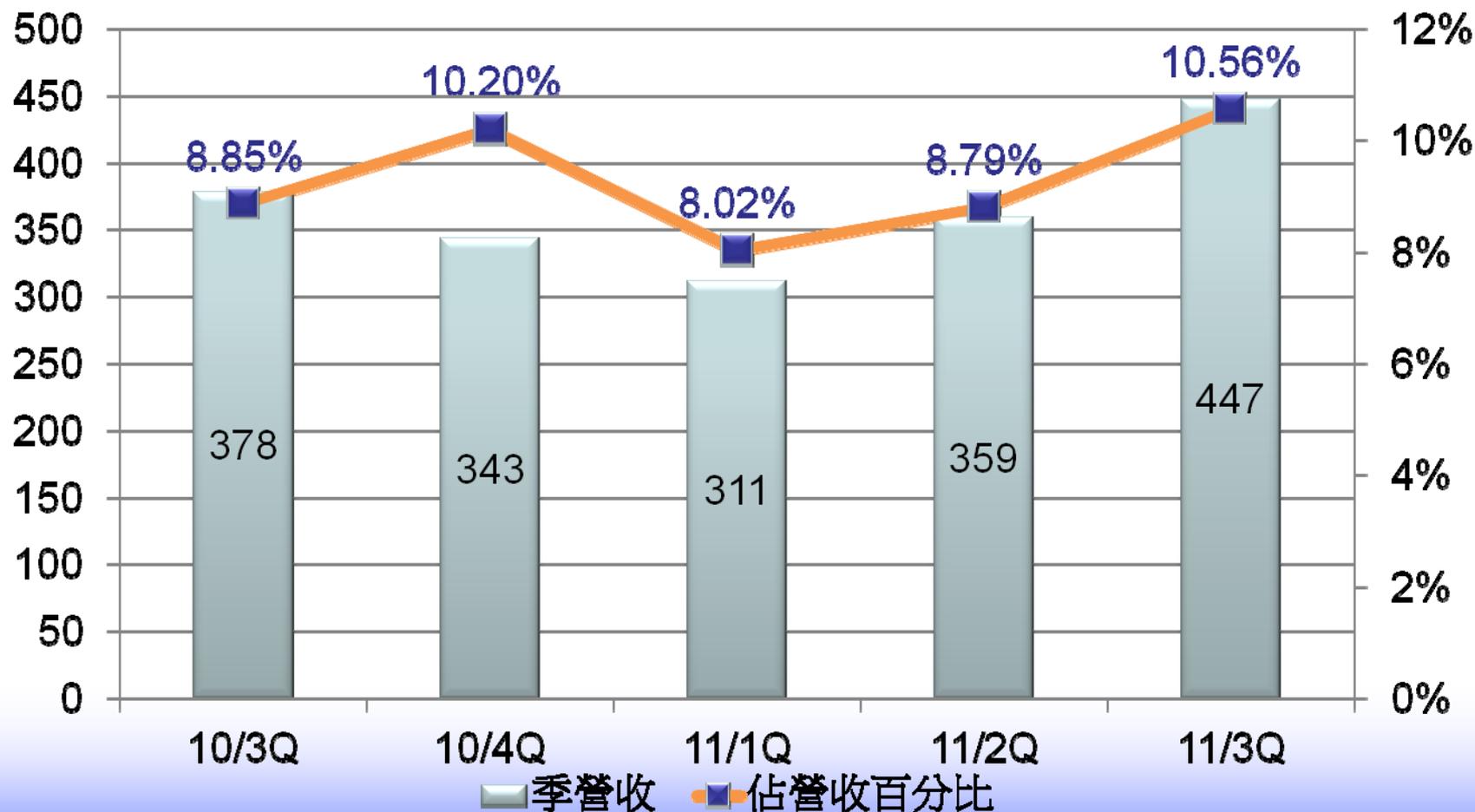
Touch材料營收趨勢

Unit: NT\$MN



Handset材料營收趨勢

Unit: NT\$MN



公司未來展望

未來成長動能

1. 新一代LCD 驅動IC之封裝材料：

Semi-additive COF

Fine Pitch Design, High **Thermal Dissipation**

輕、薄、高效能之手持式電子產品之必要材料



未來成長動能

2. 觸控面板之材料：光學膜、光學膠...

擴大產品線，打入產品供應鏈

主要供應平板電腦、智慧型手機之觸控面板基本材料



未來成長動能

3.Handset產品之材料：精密金屬零件

增加產品應用面，打入產品供應鏈

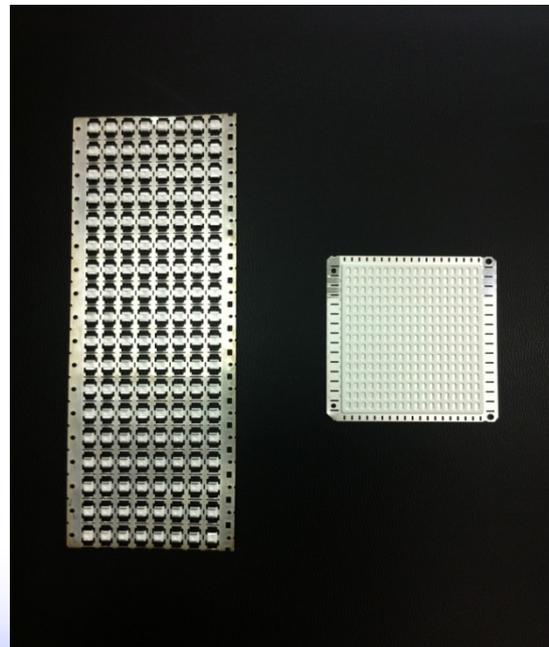
主要供應平板電腦、智慧型手機等週邊產品之基本材料



未來成長動能

4. 新一代LED導線架：

“以最低之生產成本創造最高之產品品質”



未來成長動能

5. Fine Pitch FPC :

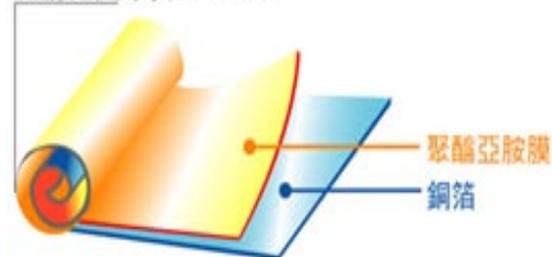
“以生產COF的高階設備產能創造高附加價值產品”

傳統FPC線路間距 70um → 30um

有膠式三層板(3-FCCL)



無膠式系列(2-FCCL)



Thank you!!

www.cwei.com.tw

Q & A